

EDITORIAL

Sensoren – ein spannendes Thema – zeitlos und aktuell 2521

VERBÄNDE

 **FBDi - Informationen** 2551
Fachverband Bauelemente Distribution e.V.

 **FED - Informationen** 2570

 **ZVEI: - Informationen** 2588
Die Elektroindustrie

 **MAPS - Mitteilungen** 2615
DEUTSCHLAND

 **3-D MID - Informationen** 2635

 **DVS - Mitteilungen** 2658

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 2524

Neue Normen 2534

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 2535

electronica: Internet 4.0 – making the world smarter 2539

BAUELEMENTE

Märkte für elektronische Bauelemente nachhaltig auf Wachstumskurs 2541

Sichere Steckverbinder für Industrieroboter 2543

US-Wissenschaftler lassen Laserquelle auf Siliziumchip wachsen 2546

Aktuatoren, Filter, Frontends, HF-Drosseln und µDC-DC-Wandler für diverse Anwendungen 2547

DESIGN

Plattform senkt Entwicklungszeiten und -kosten für komplexe Display-Lösungen 2555

Der USB-Typ C soll Geräteverbindungen über Kabel wesentlich sicherer, schneller und effektiver machen 2556

Lean-NPI-Applikation aus der EMS-Perspektive 2562

22. FED-Konferenz zeigte Zukunftschancen auf 2567

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit):
 Eine neue Dimension: LED-Matrix-Frontscheinwerfer 2575

LeitOn startet Online-Kalkulation 4.0 2579

Hochfrequenz in der Entwicklung und Herstellung von Leiterplatten 2581

Neue Chancen und Herausforderungen beim Einsatz von Alu für die Leiterplattentechnologie 2585

Neue Bauteilbibliotheken für Leiterplatten 2586

BAUGRUPPEN & SYSTEME

MID 2014 – Internationale Plattform der Mechatronikforschung 2593

Einfache und professionelle Reinigung von SMD-Schablonen verhindert Ausschussware 2598

Elektronik-Montagerichtlinien IPC J-STD-001F und IPC-A-610F in neuer Ausgabe 2601

WX-Plattform mit passender WXR-3-Rework-Station komplettiert 2603

Sicherheit großgeschrieben 2604

Technologietage zur Zukunft der Automatenbestückung 2606

Technologietage treffen auf starke Resonanz 2611

Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht 2613

ANALYTIK & TEST

VIP 2014 – weit mehr als Test- und Messtechnik 2626

NI senkt mit PXI-basierten Testsystemen Kosten für automatisierte Halbleiterprüfsysteme 2628

Den Bereich Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen für externe Firmen verstärkt 2629

Universelles Röntgeninspektionssystem X8068 2632

Enjoy Testing – Inspection Days unterm Firmament 2633

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Mobile Handscanner für die spektraloptysche Analytik 2638

Intelligente Mikrosensoren zur breitbandigen Charakterisierung von Flüssigkeiten 2645

Wirtschaftlicheres Verfahren für Micro Energy Harvesting entwickelt 2651

Patente 2654

FORUM

Mit beharrlichen Schritten zu mehr Miniaturisierung, neuen Elektronikanwendungen und der vernetzten Gesellschaft der Zukunft	2659	Kolumne: Da bleibt kein Auge trocken	2680
Programmierbare Lösungen für kabelloses Laden	2671	PLUS-Firmenverzeichnis	2682
Microelectronics Saxony – Licht in neuer Form und Anwendung	2673	Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	2706
		Inserentenindex	2708
		Stellenmarkt	2709
		Mediadaten	2710
		Impressum	2711
		Produkt des Monats	2712

Titelbild: www.leiton.de – Die wohl umfangreichste Onlinekalkulation der Welt

Einfach und bequem online günstige Standard-Pool-Platinen bis hin zu Hochtechnologie kalkulieren: Aluminiumträger- und Aluminiumkernleiterplatten, Dickkupferplatinen, Rogers-Hochfrequenzleiterplatten, Flexplatinen und mittlere Serien bietet LeitOn transparent, günstig und bequem online an – vieles auch ab 12-Stunden Express. Lesen Sie mehr dazu – ab Seite 2579 – wie LeitOn die Standards voran treibt und neue Maßstäbe im Bereich der Leiterplatten-Onlinekalkulation setzt.

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.
Tel. +49 (0) 8563 9788908
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49/30/8349059
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.
Tel. +49/3677/69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/91 1/5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.